

平成28年度世界一を目指す研究開発助成事業の交付一覧

| 番号 | 交付決定者 | 代表研究者（所属・役職）、研究開発テーマ及び概要 |
|----|---------------------|---|
| 1 | 小山工業高等専門学校 (小山市) | <p>大島 心平(おおしま しんぺい)氏 (電気電子創造工学科・講師)</p> <p>「整合回路の新規設計法による高減衰特性を有する小型ダイプレクサの開発」</p> <p>～概要～</p> <p>近年、多くの物に無線通信機能が搭載されており、電気信号を分離する回路(ダイプレクサ)は非常に重要な技術になってきている。</p> <p>本研究では、従来に例のない手法を用いて高減衰特性を有する小型ダイプレクサの整合回路の設計法を構築する。</p> <p>この手法は特殊な工法を用いない上、無線通信機器の小型化、通信品質の向上が可能なるため、多くの企業でのIoT関連事業への活用が期待できる。</p> <p>交付決定額：1,000,000円</p> |
| 2 | 桑名商事株式会社 (真岡市) | <p>大和 亜矢(やまと あや)氏 (技術管理部研究開発課・リーダー)</p> <p>「低応力無電解ニッケルめっき膜の開発」</p> <p>～概要～</p> <p>近年、無電解ニッケルめっき膜を応用した超薄肉金属製品の需要が急増している。</p> <p>本研究では、内部応力の極めて低いめっき膜を開発することで本製品の耐久性を向上させ、これまで問題であった製品形状の制限及び高額な製造コストの発生の解決を図る。</p> <p>これにより、超薄肉金属製品における様々な形状への超薄肉金属成形、製造コストの低減の実現でき、様々な産業ニーズに対応が可能となる。</p> <p>交付決定額：921,700円</p> |